

苏州国芯科技股份有限公司

2022年8月投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2022-007

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	<p>汇添富基金：马磊、詹杰；</p> <p>嘉实基金：陈俊杰、蔡丞丰、丁杰人、谢泽林；</p> <p>华夏基金：李明斯、景然；</p> <p>博时基金：程沅、张朱霖；</p> <p>大成基金：吴志强、魏庆国；</p> <p>上投摩根基金：杨鑫；</p> <p>长信基金：李欣；</p> <p>鑫元基金：陆杨；</p> <p>华安基金：祝希瑀；</p> <p>利幄基金：孟舒豪；</p> <p>富荣基金：李延铮；</p> <p>中加基金：吕航；</p> <p>淳厚基金：陈文；</p> <p>民生加银基金：孙金成；</p> <p>兴业基金：肖滨；</p> <p>银华基金：刘一隆；</p> <p>西部利得基金：温震宇、张昌平；</p> <p>贝莱德基金：王瀚仪；</p> <p>华泰保兴基金：符昌铨；</p> <p>万家基金：武玉迪、陈飞达；</p> <p>浙商基金：王斌；</p>

凯石基金：王磊、陈晓晨；
华宝基金：罗彦；
建信基金：李慧丰；
中信建投基金：周户；
盘京投资：王莉；
人保资产：刘洋；
恒生前海：李峥嵘；
华泰柏瑞：王林军、骆梦涛；
逸融投资：陈祯；
国泰君安证券：舒迪、肖凯；
众安保险：高翔；
磐厚动量：孟庆锋；
河清资本：李泽豪；
禹合资产：丁凌霄；
东方资管：虞圳劬；
景熙资产：詹林钰；
西南自营：刘淑娴
兆天投资：郑奇伟；
华宝兴业：涂围；
中泰证券：杨旭；
北京泽铭投资有限公司：安晓东；
深圳市景泰利丰投资发展有限公司：吕伟志；
Hel Ved Capita: daniel；
光大证券：陈峰；
申万宏源证券：陈旻；
上海利幄私募基金管理有限公司：孟舒豪；
丰琰投资管理（上海）有限公司：孙啸；
北京泓澄投资管理有限公司：刘竞远；
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited: 丑凯亮；

中信建投经管委财富管理部客户：杨如丰；
北京合创友量私募基金管理有限公司：王艺璇；
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）：陈俊；
国华兴益保险资产管理有限公司：王霆；
厦门金恒宇投资管理有限公司：王晓强；
北京源闾投资基金管理有限公司：刘春昊；
北京致顺投资管理有限公司：朱贺凯；
天津易鑫安资产管理有限公司：王青晨；
华金证券：费霆；
中信证券：罗毅超；
长江养老保险股份有限公司：黄学军；
恒泰证券：徐结文；
海南拓璞私募基金：邹辰；
上海东方证券资产管理有限公司：虞圳劬；
上海晟盟资产管理有限公司：黄思琴；
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司：查行楷；
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited: Wenjin Hu (Sharon);
申万宏源证券：邓拥军；
浙江浙商证券资产管理有限公司：赵媛；
Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd.: 董丰侨；
致合（杭州）资产管理有限公司：张晓猛；
上海歌汝私募基金管理有限公司：阮辽远；
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司：鲍炜；
上海和谐汇一资产管理有限公司：梁爽；
太平洋资产管理有限责任公司：陈永亮；
建信信托有限责任公司：吴晓鹏、冷玥；
东海证券：易尚；
广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司：汤衡；
北京水印投资管理有限公司：沃子尧；

	<p>海南拓璞私募基金管理有限公司：俞海海；</p> <p>上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）：杜彤；</p> <p>北京比特资本投资管理有限公司：徐荣正；</p> <p>上海仁布投资管理有限公司：王卓尔；</p> <p>上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）：赵浩；</p> <p>汇华理财有限公司：张运昌；</p> <p>北京鸿道投资管理有限责任公司：方云龙；</p> <p>上海和谐汇一资产管理有限公司：梁爽；</p> <p>中国电子投资控股有限公司：刘晨光；</p> <p>天津易鑫安资产管理有限公司：王青晨；</p> <p>CENTERLINE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED：郑天涛；</p> <p>彤源投资：文琦；</p> <p>上海泰旻资产管理有限公司：王丛；</p> <p>方正证券：吴文吉、陈瑜熙、常密密；</p> <p>尚善资产：周敏；</p> <p>招商资管：何怀志；</p> <p>新华资产：王羽展；</p> <p>北京城天九投资有限公司：魏静；</p> <p>上海泰旻资产管理有限公司：汤明泽；</p> <p>个人：徐博、李明斯、梁斌、李甜、薛林立、李志毅；</p>
<p>时间</p>	<p>2022年8月24日 15:00</p> <p>2022年8月25日 15:00</p> <p>2022年8月26日 10:00</p> <p>2022年8月26日 15:00</p> <p>2022年8月29日 13:30</p> <p>2022年8月29日 15:30</p> <p>2022年8月30日 10:30</p> <p>2022年8月31日 14:00</p>
<p>地点</p>	<p>线上交流及公司大会议室现场交流</p>

<p>上市公司参加人员姓名</p>	<p>董事长：郑荏先生 董事会秘书：黄涛先生 董事会秘书办公室：龚小刚先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>投资者就其关心的问题，向公司提出了问题，公司参会人员进行了回复，主要情况如下：</p> <p>1、能否介绍一下各类汽车芯片的进展及下游客户情况？</p> <p>答：车身控制领域：公司于 2022 年上半年推出的 CCFC2012BC 中高端车身及网关控制芯片，可对标国外产品如 NXP（恩智浦）MPC5604BC、MPC5607B 系列以及 ST（意法半导体）的 SPC560B50、SPC560B64 系列，受到市场的普遍欢迎，订单增加较快，客户包括多家 Tier1 模组厂商和国内主要的汽车品牌厂商，该芯片采用自主可控的 PowerPC 的指令集。截至 2022 年 6 月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过 200 万颗订单，并实现几十万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动及 T-BOX 等应用，可实现对国外产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等；预计下半年还会有新的订单。</p> <p>汽车动力总成控制领域：公司构建了和汽车发动机领域头部客户和动力总成控制模组头部厂商为主的战略合作关系格局，共同定义新产品，实现国产化替代。汽车发动机芯片技术难度大，但市场急需国产化。公司已研发成功 CCFC2003PT、CCFC2006PT 等型号芯片产品，其中 CCFC2003PT 对标 NXP（恩智浦）MPC5634、CCFC2006PT 对标 NXP（恩智浦）MPC5554，并已在重型发动机中获得实际应用，对标 NXP（恩智浦）MPC5674 的 CCFC2007PT 已内测成功，对标 NXP（恩智浦）MPC5777 的 CCFC3007PT 芯片产品正在设计中，可覆盖传统的汽柴油发动机、新型混动发动机及电动机应用需求。动力总成控制芯片需要更长的时间进行应用验证，公司目前正在和相关厂商紧密合作，争取尽快实现产业化规模应用。目前国内能开展汽车动力总成控制芯片研发的厂商还很少，公司在国内处于领先地位。</p> <p>汽车域控制器领域：公司正在开发汽车域控制器芯片 CCFC2016B，进展顺利，该芯片的产品定义过程中充分征求了国内头部新能源汽车厂商的意见。</p> <p>新能源电池 BMS 控制领域：公司新能源电池管理芯片 CCFC2007PT 已成功流片并且内测成果，公司已开展新一代高端新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT 的研发，进展顺利。</p>

车规级安全 MCU 芯片：公司已成功开发 CCM3310S-T、CCM3310S-H 和 CCM3320S 等三款汽车电子安全芯片产品，形成高、中、低产品系列，其中 CCM3310S-T/CCM3310S-H 已批量供货，CCM3320S 正在进行客户验证阶段并实现小批量销售，主要对标国际领先厂商恩智浦和英飞凌相关产品，主要应用包括车载 T-BOX 安全单元、车载诊断系统（OBD）安全单元、车联网 C-V2X 通信安全应用等。上述芯片产品已获得车规级认证，并获得国家密码管理局的信息安全产品的型号认证，已进入汽车 T-BOX 和 OBD 等领域的产品应用，成为公司大型汽车模组厂商的前装 OBD、T-BOX 和 ETC 等领域的产品序列，在国内车规安全芯片市场影响力逐步扩大。

在其他应用领域，公司也开始瞄准汽车电子电源管理类芯片领域国产化替代机会，启动汽车门控混合信号芯片 CCL1100B 的研发，实现对国外产品的替代。

上半年汽车电子芯片加车规级安全芯片销售收入比去年同期增长 300%以上。受国家对汽车产业政策带动、汽车缺芯、国产替代等因素的大力推动，今年下半年国产汽车芯片需求继续旺盛。汽车电子芯片的客户包括埃泰克、科世达等 10 多家的模组厂商，潍柴动力等多家发动机厂商，和长安、奇瑞、上汽和比亚迪等众多汽车整机厂商。

2、公司明年产能情况会不会缓解？明年订单情况如何看？

答：目前，公司大部分工艺线的产能现在已经缓解或部分缓解。汽车电子工艺产能依旧紧张，但预计明年上半年会得到一定缓解。明年订单情况请以公司的临时报告和定期报告上披露的数据为准。

3、可否介绍一下今年公司芯片定制服务业务的情况？

答：上半年，公司的定制芯片业务情况良好，自主可控与国产替代需求旺盛。从上半年的经营数据上看，IP 授权 4043.39 万，同比增长 57.99%；芯片定制服务和量产服务 8368.06 万，同比增长 318.76%（其中定制设计服务 3753.84 万元，同比增长 413.58%；量产服务 4614.22 万，同比增长 264.08%）。就目前我们了解的情况来说，下半年的公司的 IP 授权与定制服务需求在很大程度上会继续强劲，具体业务情况请以公司在定期报告和临时报告上的信息披露结果为准。

4、我们如何看带芯片定制服务业务的增速？主要由什么原因决定的？

答：由于自主可控与国产替代需求旺盛，我们的芯片定制服务业务也保持了较强的增长。部分国内行业龙头企业希望提高核心竞争力，自己定义具有更大竞争力、融入自己算法、技术、知识产权的更适合市场需求的芯片，从而提高自主可控性。

5、云安全芯片产品情况和单价如何？下游客户主要是？

答：云安全芯片属于高端 SoC 芯片，公司产品具有国际先进水平。上半年，公司的云安全芯片产品与去年上半年同比增长 76%；平均单价在 1000 元以上。根据目前的市场开拓情况看，我们该类产品预计下半年应用量会更大。该产品主要应用于服务器、VPN 网关、防火墙、安全路由器、密码机、视频监控中心、电力隔离设备、5G 基站、智能驾驶路侧设备等，实现可信计算、数字签名、加解密运算等功能。主要客户包括深信服、信安世纪、格尔软件、国家电网等等。

6、终端安全产品的下游应用主要为哪些领域？不同领域产品单价是差不多的吗？

答：公司终端安全产品主要应用领域有智能门锁、POS 机、视频监控安全、加密存储设备、物联网安全、智能电网设备安全等。我们的终端安全产品有不同的系列，单价根据性能、销售量等的要求，从几元到几十元不等。

7、公司汽车电子业务的下游的客户主要有哪些？

答：公司汽车电子芯片的下游客户主要有比亚迪、长安、长城、奇瑞、上汽、东风等国内汽车整机厂商，还包括埃泰克、科世达等 Tier1 汽车电子模组厂商，公司与下游的客户有较为密切的合作。

8、公司下半年和明年研发投入及费用的预期？

答：公司会根据市场需求和公司发展规划增加研发投入，尤其是在汽车电子芯片、Raid 芯片和云安全芯片等领域会加大投入，研发出具有国际先进水平的产品系列，占领国内市场，实现国产化替代。

9、下游晶圆厂的产能是否仍然处于紧张状态？目前价格情况如何？

答：大部分工艺的晶圆产能已缓解，汽车电子芯片工艺的产能依旧紧张，公司已落实今年的产能，并正在和晶圆厂落实明年的产能，预计可以获得保障。下游晶圆厂价格属于敏感信息，我们需要负保密责任，不方便透露。

10、云安全芯片的产品进展以及市场需求情况？

答：“云”安全芯片领域，公司的技术可支持多种国密算法和国际通用密码算法，具有高性能 CPU 内核和 PCIe/USB/SPI 等多种外设接口。CCP903T 系列云安全芯片对称算法的加解密性能达到 7Gbps，哈希算法性能达到 8Gbps，非对称算法 SM2 的签名速度达到 2 万次/秒、验签速度达到 1 万次/秒，并已通过国密二级安全认证，具备较强的市场竞争力，可广泛应用于密码设备、服务器与桌面 PC、VPN 网关、路由器、智能交通路侧设备

和智能电网控制设备等领域。新一代 CCP908T 系列云安全芯片对称算法的加解密性能达到 30Gbps，哈希算法性能达到 30Gbps，非对称算法 SM2 的签名速度达到 15 万次/秒、验签速度达到 8 万次/秒，综合性能达到国际龙头企业同类产品的技术指标，具有国际先进水平。“云”安全芯片上半年完成销售比去年同期增长 76%。

11、目前公司的汽车芯片的在手订单情况如何？车身控制芯片比如 2012BC 在下游客户推广的进展如何？对于未来产品的价格趋势如何展望？

答：公司于 2022 年上半年推出的 CCFC2012BC 中高端车身及网关控制芯片，可对标国外产品如 NXP（恩智浦）MPC5604BC、MPC5607B 系列以及 ST（意法半导体）的 SPC560B50、SPC560B64 系列，受到市场的普遍欢迎，订单增加较快，客户包括多家 Tier1 模组厂商和国内主要的汽车品牌厂商，该芯片采用自主可控的 PowerPC CPU。截至 2022 年 6 月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过 200 万颗订单，并实现几十万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动及 T-BOX 等应用，可实现对国外产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等。目前下游的涵盖整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等，预计随着公司产品前装应用量增加和影响力增加，芯片的订单及出货增长量会进一步增加。预计未来产品价格保持稳定。

12、公司在 Chiplet 领域有没有相关的规划？如何看待 Chiplet 对公司的 IP 授权及其他产品业务的影响？

答：公司在积极布局 Chiplet 技术。目前公司国家重大需求、信息安全以及边缘计算和网络通信等领域有多个 SoC 芯片正在进行多芯片合封，最多已经实现 6 颗裸 Die 的合封。公司目前正在研究规划合封多 HBM 内存的 2.5D 的芯片封装技术，积极推进 Chiplet 技术的研发和应用，今后可以更好提升产品性能、更大范围拓展公司的业务。

13、公司的 IP 授权与定制服务业务情况是怎么样的？从目前时间点来看，下半年 IP 授权与定制服务的下游需求情况如何？明年如何展望？

答：上半年，IP 授权 4043.39 万，同比增长 57.99%；芯片定制服务和量产服务 8368.06 万同比增长 318.76%（其中定制设计服务 3753.84 万元，同比增长 413.58%；量产服务 4614.22 万，同比增长 264.08%）

公司将架构设计、自主可控的嵌入式 CPU 内核、关键外围 IP、SoC 软件系统验证环境、面向应用的基础软硬件与中间件等进行集成，推出了面向信息安全、汽车电子和工

	<p>业控制、边缘计算和网络通信三大应用领域的 SoC 芯片设计平台。通过设计平台可以有效提高芯片设计效率和设计灵活程度，缩短设计周期，并大幅提高芯片设计一次成功率。公司 SoC 芯片设计平台已承担多个领域的重大产品项目，实现了 14nm/28nm/40nm/65nm/90nm/130nm/180nm 等工艺节点芯片的快速开发。目前每年基于平台完成数十款芯片的设计和数千万颗芯片的量产，平台技术成熟、稳定、可靠。目前国产化替代需求日益增强，在国家重大需求、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等领域下游客户需求强劲，下半年和明年的 IP 授权与定制服务业务的具体情况请以公司在定期报告和临时报告上披露的信息为准。</p> <p>14、公司上半年收入结构占比拆分，从下游应用领域怎么分？从产品看，自主芯片和模组产品中端安全、云安全和汽车芯片的收入占比？</p> <p>答：上半年营收达到 20,924.05 万元人民币，同比增长 49.16%；归属上市股东的净利润达到 6,103.68 万元人民币，同比增长 1,823.09%；扣非后净利润达 1946.25 万元人民币，与上年同期相比扭亏为盈。</p> <p>从应用端来看，信息安全方向收入为 10,519.05 万元，同比增长 12.95%；汽车电子和工业控制方向收入为 4,756.39 万元，同比增长 172.51%，业务领域呈扩大趋势；边缘计算和网络通信方向收入为 5,421.32 万元，同比增长 117.59%，同样增长强劲。</p> <p>从业务结构来看，芯片定制服务收入达到了 8368.06 万元，比上年同期增长 318.76%。自主芯片和模组收入 8,285.31 万元，其中国家重大需求应用、汽车电子、云安全和端安全芯片收入占比分别为 24.84%、16.49%、8.94%和 49.73%。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 8 月</p>